



性能特点

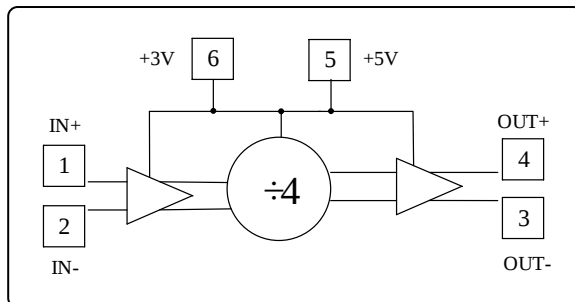
工作频段: 0.1-13 GHz

输出功率: 0 dBm

电源供电: +3V / +5V@ 71 mA

芯片尺寸: $1.2 \times 0.6 \times 0.1 \text{ mm}^3$

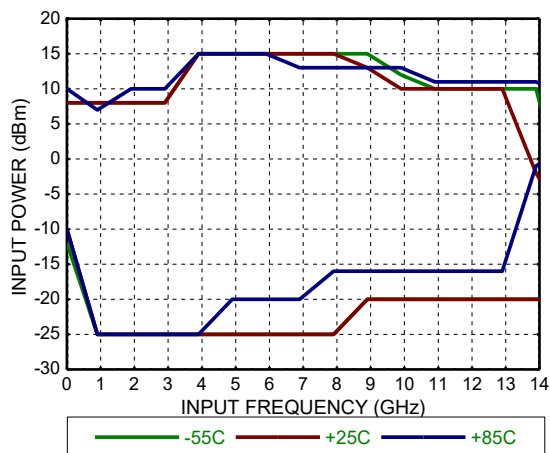
功能框图



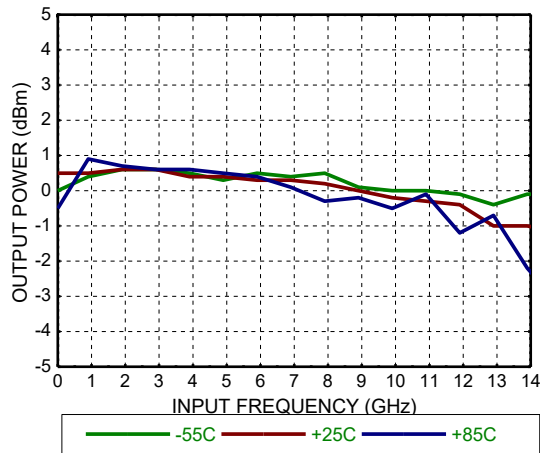
电特性参数 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = +3\text{V} / +5\text{V}$, $I_{DD} = 71 \text{ mA}$)

参数	条件	最小	典型	最大	单位
最高输入频率	正弦波		13		GHz
最低输入频率	正弦波		0.1		GHz
输入功率范围	$f_{IN} = 0.1 - 13 \text{ GHz}$	-25	0	+15	dBm
输出功率	$f_{IN} = 0.1 - 13 \text{ GHz}$		0		dBm
单边带相位噪声	$P_{IN} = 0 \text{ dBm}$, $f_{IN} = 4 \text{ GHz}$		-150		dBc/Hz
工作电流	+3V		71		mA
	+5V				

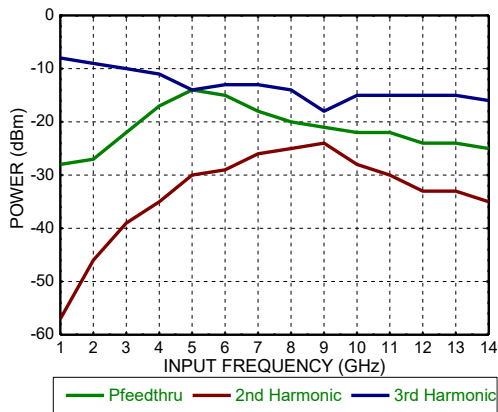
输入灵敏度窗口 vs. 温度



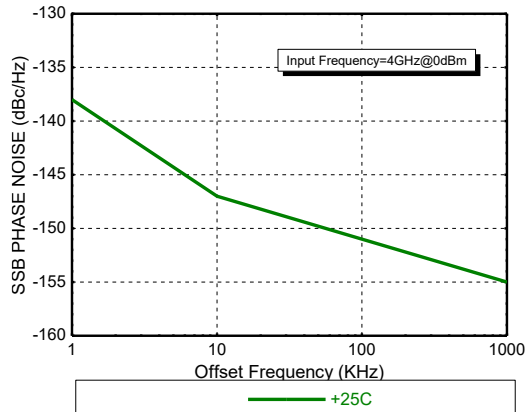
输出功率 vs. 温度



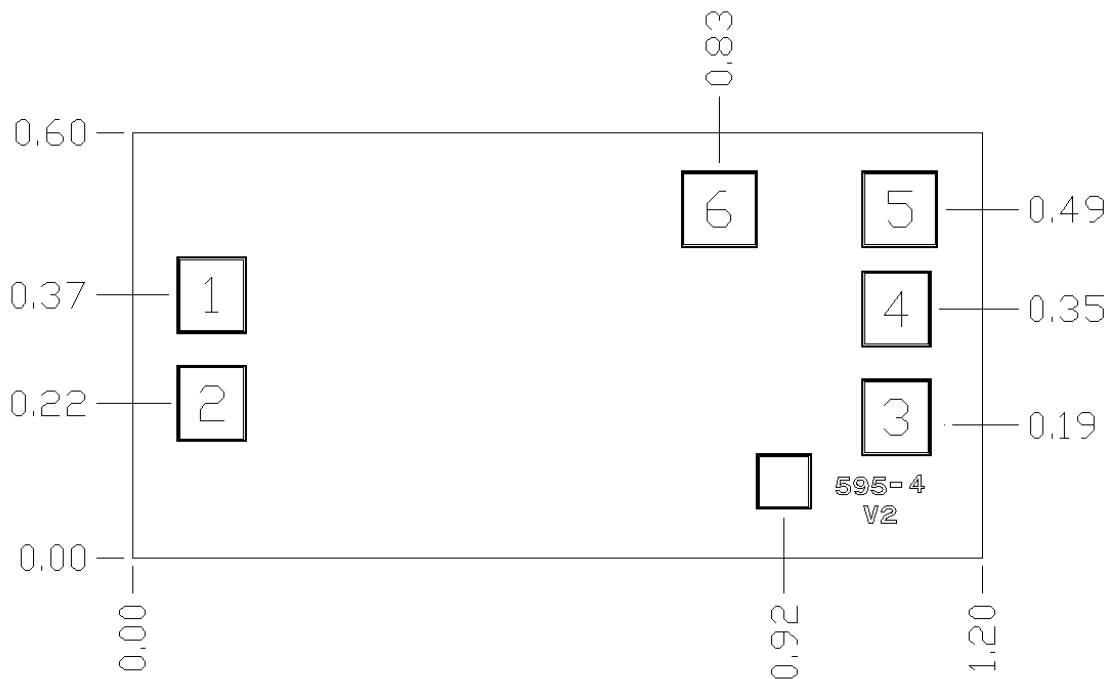
输出谐波, $P_{in}=0\text{dBm}$, $T=25^\circ\text{C}$



SSB相位噪声, $T=25^\circ\text{C}$

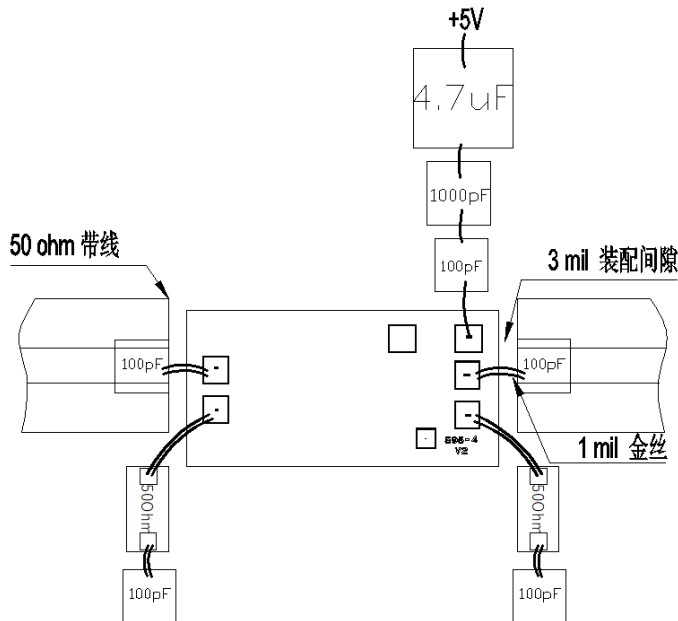


物理参数





装配图



注：该装配图为单端使用情况，如需差分使用，输入输出引脚均需接 100pF 隔直电容。

焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN+	该焊盘是射频输入端（需外接 100pF 隔直电容）
2	IN-	该焊盘是射频输入端（单端使用时需外接 50ohm 电阻与 100pF 隔直电容到地）与焊盘 1 相位相差 180°
3	OUT-	该焊盘是分频信号输出端（单端使用时需外接 50ohm 电阻与 100pF 隔直电容到地）
4	OUT+	该焊盘是分频信号输出端（需外接 100pF 隔直电容）与焊盘 3 相位相差 180°
5	+5V	该焊盘是+5V 电源端，需要外接 100pF/1nF/4.7μF 旁路电容，+5V 电源与+3V 电源焊盘选用一个即可
6	+3V	该焊盘是+3V 电源端，需要外接 100pF/1nF/4.7μF 旁路电容，+5V 电源与+3V 电源焊盘选用一个即可
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至地

极限参数

供电电压: +5.5V(引脚 5)、+3.5V(引脚 6)

储存温度: -65~+150°C

工作温度: -55~+125°C